



本社(愛知県知立市) 加工設備一覧表

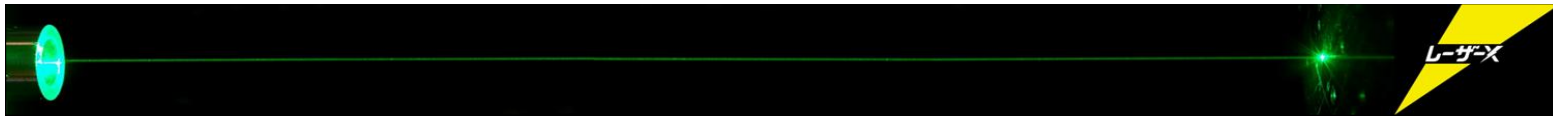
2026年3月9日現在

レーザーの種類	メーカー/代理店	型式	定格出力 / ピーク出力	加工最大寸法 (L×W×H)	主な加工用途	加工能力及特徴
ファイバーレーザー	IPGフォトンクス	YLR-5000	5kW	800×460×520	切断・溶接	4軸同期機能、NCロータリーテーブル付き。スポット径φ0.2、0.4、0.6他要望に合わせて対応。同軸カメラ付
	IPGフォトンクス	QCW-150	150W/1.5kW	300×300×400	切断、溶接、孔あけ	シングルモードFBLで微細切断、溶接、孔あけが可能。リニアモーターによる門型の小型加工機に搭載。
	IPGフォトンクス	QCW-150	150W/1.5kW	500×500×200	切断、溶接、孔あけ	シングルモードFBLで微細切断、溶接、孔あけが可能。NCロータリー付き
	IPGフォトンクス	QCW-300	300W/3kW	350×350×400	切断、溶接、孔あけ、マーキング	2次元加工機、同軸カメラ付。マルチモードFBL。YAG/パルスからの置き換え。安定したビーム品質。
	IPGフォトンクス	QCW-300	300W/3kW	450×170×400	切断、溶接、孔あけ、マーキング	2次元加工機、5軸制御 同軸カメラ付。マルチモードFBL。YAG/パルスからの置き換え。安定したビーム品質。
	IPGフォトンクス	QCW-600	600W/6kW	900×600×440	切断、溶接、孔あけ、マーキング	2次元加工機、5軸制御 同軸カメラ付。マルチモードFBL。YAG/パルスからの置き換え。安定したビーム品質。
	IPGフォトンクス	QCW-1500	1500W/15kW	600×600 (テーブル寸法)	切断、溶接、孔あけ	6軸多関節ロボットによる3次元物体への切断、溶接、孔あけ可。ピーク出力15kWで厚板切断、深孔加工にも対応。
	IPGフォトンクス	QCW3600	3.6kW/36kW	1000×350×650	切断、孔あけ	自社製3次元加工設備：3次元物体への孔あけ、切断可。ピーク出力36kWで深孔加工にも対応。
	コヒレント	HighLight FL2000CSM	2kW	600×600×450	精密高速切断、溶接、孔あけ	リニア軸採用による高速度、高精度加工が可能。ファイバーコア径φ0.02のシングルモードFBLで薄板の精密高速切断に最適。出力範囲下限1%から設定可能。
	三菱電機	MF100	10kW	600×600×450	切断、溶接、孔あけ	自社製加工ヘッド加工設備によるオール国産レーザー加工設備ラボにて加工設備導入検証試験加工に対応
	住友重機械工業	LASERDYNE 795XL QCW-2000	2kW/20kW	2000×1000×1000	切断、孔あけ	3次元物体への孔あけ、切断可。ピーク出力20kWで深孔加工にも対応。
	パナソニック電工 SUNX	LP-S500	42W	90×90	マーキング	42Wのハイパワーによる金属への高速深彫り印字。薄板や樹脂の切断・孔あけや、樹脂溶着も可能。
テクノコート	TL-150LD	150W/1.5kW	500×400 (テーブル寸法)	補修肉盛り溶接	手動ステージとマイクロスコープ及び同軸カメラを用いた微細溶接。	
ナノ秒短パルスレーザー	トルンプ	TruPulse2020nano	200W	420×170×470 回転軸 ~200rpm	微細加工	2Dスキャナ・単光ヘッドの組み替え可能。3軸直行NC加工機の組み合わせで切断・孔あけに加え溝掘り・ディンプル・表面除去・ステータリングと様々な微細加工が可能。
ディスクレーザー	トルンプ	TruDisk6001	6kW	1300×800×500	切断、溶接	NC4軸+回転ロータリー制御で様々な形状の加工に対応。BLW制御によるスパッタ低減の高品質な溶接が可能。最小スポット径φ0.1。
CO ₂ レーザー	澁谷工業	SPL2305-E400	400W/1kW	500×500×65	精密切断	金属材料やセラミクス、樹脂などの薄板精密切断。オフセットカメラ取付により追加加工にも対応可能。
	インテック	SR15i	130W(9.3μm)	75×75 (2Dスキャナ)	表面加工、切断・孔あけ(樹脂)	ガラスや樹脂材料の表面加工、メッキ除去、クリーニング他樹脂材料への切断加工・孔あけ加工
半導体レーザー	浜松ホトニクス	LD-HEATER	70W	600×600 (テーブル寸法)	樹脂溶着	6軸多関節ロボットを利用して3次元形状の樹脂溶着が可能。温度モニターで加工状態を連続監視、加工の条件出しに利用可能。
電子ビーム	三菱電機	CNC-EBM-P-6L	6kW	500×500×500 (チャンバー寸法)	溶接	4軸同時制御可能。アップ・ダウンスロープが可能。素早い真空引きが可能。<高真空・低真空切り替えタイプ・パルス波形状制御可能>

レーザーテクニカルセンター (神奈川県横浜市) 加工設備一覧表

レーザーの種類	メーカー/代理店	型式	定格出力 / ピーク出力	加工最大寸法 (L×W×H)	主な加工用途	加工能力及特徴
ファイバーレーザー	IPGフォトンクス	YLS-10000-S2T	10kW	5000×1200×750 (SYH350)	厚板溶接、切断	高出力マルチモードファイバーレーザー。30ガルパルススキャナ取付可能。光ファイバー100μmおよび200μmにて試験対応可能。長尺物、重量物対応(最大5m)。4軸同時制御、NC制御回転軸付属
	IPGフォトンクス	YLS-2000-CT	2kW	1500×800×500 (SYH515)	精密高速溶接、切断	マルチモードファイバーレーザー。光ファイバー50μm及び100μmにて試験対応。高速・高精度での切断形状試験対応可能。4軸同時制御、NC制御回転軸付属
	IPGフォトンクス	YLR-1000-SM	1kW	500×400×700 (FY405)	精密溶接、微細切断 表面除去加工	シングルモードファイバーレーザー。いままでない高速且つ、歪みの無い溶接が実現可能。≤30kHzの高い変調がかけられるため、微細穴加工・切断にも最適。
	IPGフォトンクス	YLR-300-SM	300W	上記3種類の加工機を切り替えて対応可能	精密溶接、微細切断 表面除去加工	シングルモードファイバーレーザー。いままでない高速且つ、歪みの無い溶接が実現可能。≤30kHzの高い変調がかけられるため、微細穴加工・切断にも最適。
	IPGフォトンクス	FLS-IRM-100 (100ns/パルス)	100W		マーキング、微細孔あけ、トリミング、薄膜除去、彫刻	インテグレートドレーザーメーカー高出力100W機。マーキングから超高速での穴あけと精密彫刻が可能。リーズナブルなレーザー価格で専用機への組み込みもお任せ。
	IPGフォトンクス	YLP-RA (50ns/パルス)	30W / 20kW		微細孔あけ、トリミング、薄膜除去、彫刻	超高速での穴あけ(～1000孔/秒)とミクロン単位の制御が可能な精密彫刻が可能。リーズナブルなレーザー価格で専用機への組み込みもお任せ。
	IPGフォトンクス	YLR-150/1500-QCW (ms/パルス)	150W / 1.5kW		パルス溶接、精密高速溶接、微細切断、孔あけ	シングルモードFBLであり、尚且つ高いパルスエネルギーとピーク出力を備え、微細切断～パルス溶接まで可能な1台3役の芸達者。パルスYAGレーザー溶接機の置き換えに最適です。
	レーザーックス	OPTICEL FH-300	300W / 3.0kW	無制限(ハンドタイプ)加工機に取付も可能	パルス溶接	ハンドタイプのファイバーレーザー搭載溶接機 2.5tクラスのステンレス溶接可能、

※本社 測定機器、レーザーテクニカルセンター 測定機器 については裏面をご参照ください。



本社 測定機器

2026年3月9日現在

設備の種類	メーカー	型式	能力	ストローク (X×Y×Z)	テーブル (X×Y)	用途及び特徴
CNC画像測定機	ミットヨ	QV606 PRO	最小目盛0.1 μm	600×650×250	697×758	非接触測定 接触による破損・変形・汚損等避けたい測定物、微細な形状を拡大して測定、画像処理技術を用いた測定。
マイクロスコープ	キーエンス	VHX-5000	レンズ25～175, 500倍	75×50	180×135	二次元的な画像撮影や計測だけでなく、三次元形状測定(凹凸形状把握、段差計測)。
	キーエンス	VHX-6000	レンズ20～200, 200～2000倍	100×100×49	171×168	二次元的な画像撮影や計測だけでなく、三次元形状測定(凹凸形状把握、段差計測)。
測定顕微鏡	ニコン	MM-800/L	レンズ5,10,20倍	300×200×200	330×230	二次元的な形状測定。(画像モニター付)
ビッカース硬さ試験機	松沢精機	MXT70	50～1000gf	25×25	100×100	溶接及び熱処理後の表面硬さ測定。
引張試験機	大橋製作所	ABK1200	30kN	-	-	引張試験、圧縮試験。
X線検査システム	ソフテックス	SFX-150	管電圧0～150kV	250×330×300	280×330	溶接内部の気泡の確認等、産業用非破壊検査装置として多目的に使用。
ハンディプローブ 三次元測定器	キーエンス	XM-1500	3.6kW/36kW	(300×250×150)	-	ハンディタイプで移動も可能な三次元測定器。
画像寸法測定器	キーエンス	IM-7020	器差±5μm 最小表示0.1μm	90×90	200×200	カメラと画像処理システムにて製品の精度を測定。
パーティクルカウンター	BECKMAN COULTER	HHPC3+	0.3～10.0μm	-	-	空気中にある埃や不純物など微粒子(クリーン度)を計測。
He ¹ リークディテクター	島津製作所	MSE-2403	10 ⁻¹² ～10 ⁻⁵ Pa・m ³ /s	-	-	封止溶接後の漏れ確認。
	adixen	ASM340	10 ⁻¹³ ～10 ⁻³ Pa・m ³ /s	-	-	封止溶接後の漏れ確認。
	アルバック	HELIOT model304	10 ⁻¹² ～10 ⁻⁴ Pa・m ³ /s	-	-	封止溶接後の漏れ確認。
試料作製設備群	リファインテック	湿式高速切断機:RCA-233 精密湿式切断機:RCA-203 湿式ベルト研磨機:BGB-128 試料埋め込みプレス:MPA-524 湿式自動研磨機:APN-218B,RPO-223他 試料乾燥機:HDO-630			溶接後試料の切り出し研磨から電解エッチングまでの材料組織評価。	

レーザーテクニカルセンター 測定機器

設備の種類	メーカー	型式	能力	ストローク (X×Y×Z)	テーブル (X×Y)	用途及び特徴
マイクロスコープ	キーエンス	VHX-6000	レンズ20～200, 200～2000倍	100×100×49	233×185	二次元的な画像撮影や計測だけでなく、三次元形状測定(凹凸形状把握、段差計測、分解能1 μm)。
工場顕微鏡	ニコン	MM-22	レンズ5,10,50倍	220×80	450×250	二次元的な形状測定。
He ¹ リークディテクター	PFEIFFER	HLT260	10 ⁻¹² ～10 ⁻⁴ Pa・m ³ /s	-	-	封止溶接後の漏れ確認。
試料作製設備群	リファインテック	精密湿式切断機:RCA-203 試料埋め込みプレス:MPB-321 湿式研磨機:STO-226B 試料乾燥機:HDO-630 電解エッチング装置:EEO-300			溶接後試料の切り出し研磨から電解エッチングまでの材料組織評価。	